



5G対応、高機能化、高密度化、薄肉化など様々な特性が求められているFPC  
FPCについて市場動向から基本的な製造方法や材料／製造技術の最新動向を解説！

# 【Live配信(リアルタイム配信)】 FPCの市場と技術動向

～FPC(フレキシブル配線板)の総合知識～ ～5G対応高速伝送FPCの開発動向と今後の課題～  
～高密度配線(多層化・微細回路化)FPCの市場動向とそれに応える材料、設計、製造技術～



日時	2021年7月28日(水) 10:30～16:30	会場	Live配信セミナー ※会社・自宅にしながら学習可能です※
受講料	49,500円 ⇒ テレワーク応援キャンペーン 【Live配信/WEBセミナー受講限定】 1名申込みの場合: 受講料 定価: 35,200円 / ※E-Mail案内登録価格 33,440円 ※ E-Mail案内または郵送DM案内の希望を登録の方はE-mail案内登録価格になります。 ※ 同一企業で複数名E-Mail案内登録されている場合は、本割引ではなく「2名同時申込みで1名分無料」割引を適用させていただきます。		資料付

講師 (株)PCテクノロジーサポート 代表取締役 柏木 修二 氏 (元住友電工プリントサーキット(株) 取締役技術部長)

趣旨 スマートフォンに代表されるモバイル機器は、高性能・高機能化と同時に、軽量・薄型化を求められている。その為にデバイス・電子部品の高機能・小型・薄肉化やプリント配線板の薄肉・高機能・高密度配線化への要求がますます高まっている。特にFPCは、単なる配線材料としてだけでなく、デバイスやセンサー等、高機能部品のモジュール基板として多用され、軽量・薄型化や組み立てコスト低減に、ますますその重要性が高まっている。

今回のセミナーでは、FPCの市場動向や業界動向を解説した後、現状のFPC材料技術と製造技術、及び技術開発の動向について述べる。また今後の新しい市場として期待が高まっている5G対応高速伝送FPCや車載用途向けを中心に、次世代高機能FPCの技術開発動向と課題についても解説する。最後に弊社が継続的に実施している、最新のモバイル機器の分解調査から得られた知見に基づき、今後のFPCに関連する技術動向や需要動向を予測する。

プログラム	<p>1. FPCの市場動向</p> <p>(1)FPC市場の変遷 (2)FPCの生産額の推移 (3)FPCの用途別シェアと用途別採用例</p> <p>2. FPCの業界動向</p> <p>(1)FPCメーカー別グローバルシェア (2)FPCメーカーの売上額と損益の推移 (3)FPCメーカーの生産拠点 (4)FPCメーカーを中心としたサプライチェーン (5)主要FPCメーカーの概況 (6)主なリジッドフレキメーカー</p> <p>3. FPCの構成材料と技術動向</p> <p>(1)FPCとリジッドフレキの基本構造と材料構成</p>	<p>(2)FPCの絶縁材料と銅箔の特徴 (3)FCCLの種類と特徴 (4)カバーレイの種類と特徴 (5)シールド材の種類と特徴 (6)補強板の種類と特徴 (7)接着剤の種類と特徴</p> <p>4. FPCの製造技術動向</p> <p>5. 次世代FPCの技術開発動向</p> <p>6. モバイル製品の分解調査と今後のFPCの需要・技術動向</p> <p>□ 質疑応答 □</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。予め「Zoom」のインストールが可能か、接続可能か等をご確認ください。セミナー資料(製本テキスト)はお申し込み時のご住所へ開催日4.5日前に発送させていただきます。詳細はホームページをご確認下さい。

■2名同時申込みで1名分無料■  
(1名あたり定価半額の24,750円)

※2名様ともE-Mail案内登録をしていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。  
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。  
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。  
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。  
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙	B210748 (FPC)	お申し込みにはS&T会員の事前登録が必須となります
----------	---------------	---------------------------

会社名 団体名		
部署		
役職	〒	
ふりがな	住所	
氏名		
TEL	FAX	
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。	

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。  
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

<p>今後のご案内</p> <p><input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み ) E-Mail案内登録価格 <input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み ) を適用いたします。 <input type="checkbox"/> 希望しない (E-mailアドレス必須)</p>
<p>お支払方法</p> <p><input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日)</p>
<p>通信欄</p>

●受講料について  
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。  
●お申込みについて  
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。  
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。  
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。  
●お支払いについて  
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。  
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。  
振込手数料はお客様がご負担ください。

●個人情報の取り扱いについて  
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。  
詳しくはホームページをご覧ください。  
●キャンセル規定  
開催日から逆算(営業日・土日・祝祭日等を除く)いたしまして、  
・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。  
・開催3～6日前でのキャンセル: 受講料の70%  
・開催当日～2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%  
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

**S&T** サイエンス & テクノロジー  
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍  
サイエンス&テクノロジー株式会社  
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187  
〒105-0013  
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F  
https://www.science-t.com